**삼성디스플레이 입사지원서**

***※ 입사지원서 작성 시,***

***전현직 직장의 영업비밀을***

***침해하는 일이 없도록 각별히***

***유의해 주시기 바랍니다.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **성명** | (한글) (한자)  (영문) | **생년월일** | YYYY. MM.DD |
| **최종학력** | 석사 과정이면 ‘학사’ 기재  박사 과정이면 ‘석사’ 기재  석박통합과정이면 ‘학사’ 기재 | **학위** | ( 년차/ 학기)  [ 과정] |
| **실험실명** | (지도 교수: ) | **휴대전화** |  |
| **E-mail** |  | | |
| **주소** | ( - ) | | |
| **지원분야** |  | **추천인** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **학**  **력** | 구 분 | 입학년월 | 졸업년월 | 학교명 | 학과 | 세부전공명 /내용 | 성적 | 소재지 |
| 고등학교 | YYYY.MM | YYYY.MM |  |  |  |  |  |
| 대 학 교 |  |  |  |  |  | / |  |
| 대학원(석사) |  |  |  |  |  | / |  |
| 대학원(박사) |  |  |  |  |  | / |  |

※석박통합의 경우 ‘(석사)’란에 ‘(통합)’으로 기재 바람

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **경**  **력** | 업 체 명 | 입사년월 | 퇴사년월 | 주요 담당 업무 기술 | 소재지 |
|  | YYYY.MM | YYYY.MM |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **병**  **역** | 병역구분 |  | 면제사유 | 기업장학생여부 | 기업체 명 | 최초선발시기 |
| 복무기간  (전문연 완료예정시기 작성) | YYYY.MM ~YYYY.MM |  | Y / N |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **외국어**  **및**  **자격사항** | 테스트명 | 시험일 | 점수/등급 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **삼성디스플레이**  **수행과제** | 수행과제 명 | ※ 기존 삼성디스플레이와의 수행과제가 있을 경우에만 기재 |
| 기간 |  |

**⬜ 연구 및 기술 경력 사항(석/박사 기간中 연구내용 기재)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **관련 기관** | **기간** | **참여 프로젝트 및 세부경력 (본인 수행 담당 업무)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**⬜ 특허 사항 (총 00건)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **발명자** | **발명의 명칭** | **구분** | **등록번호** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**⬜ 과제 수행 중 발표 기술보고서/논문 (총 00편)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **제 목** | **작성일/발간일** | **기관** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**⬜ 상벌 사항**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **내용** | **수여일** | **내용** | **기관** |
|  |  |  |  |

상기 모든 기재사항은 사실과 다름 없습니다.

2025년 월 일

작성자 : (印)

**경력 사항 기술**

(전체 보유 경력에 대해 가급적 자세히 작성)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회사명** | **직급** | **근무 기간** | **주요 업무** |
|  |  | YYYY.MM ~  YYYY. MM |  |
|  | | | |

**전공소개서**

**※ 석/박사 학위 보유자 또는**

**박사학위 취득 예정자限 작성**

(자유 형식 기술, 가급적 자세히 작성, 필요시 그림/도표 삽입 가능)

**자기소개서**

(자유 형식 기술)

**응시자 개인정보 수집∙이용 동의서**

삼성디스플레이 주식회사(이하 "회사"라 함)는 채용에 필요한 범위 내에서 개인정보 보호법 등 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하며 응시자로부터 개인정보를 수집∙이용하는데 필요한 동의를 받고자 합니다. 회사의 응시자 개인정보 보호에 대한 상세한 내용은 "http://www.samsungcareers.com"에 게시된 "개인정보 처리방침"에서 확인하실 수 있습니다.

**1. 개인정보의 수집∙이용 동의**

|  |
| --- |
| ○ 수집항목  - 입사지원 관련 사항 : 성명(한글, 한자, 영문), 생년월일, 학력(입학년월, 졸업년월, 학교명, 학과, 세부전공명, 성적), 학위,  실험실명(지도교수명), 휴대전화, E-mail, 주소, 경력(업체명, 입사년월, 퇴사년월, 주요 담당 기술, 직급), 병역(병역구분,  복무기간, 면제사유), 기업장학생여부(기업체명, 최초선발시기), 외국어 및 자격사항 (테스트명, 시험일, 점수/등급),  삼성디스플레이 수행과제(수행과제명, 기간), 연구 및 기술경력사항, 특허사항, 과제 수행 중 발표 기술보고서/논문,  장학금 수혜내역(종류, 주관, 선발시기, 수혜기간), 상벌사항, 전공소개서, 자기소개서    - 인터넷 이용에 관한 사항 : 접속 로그, 홈페이지 ID  ○ 수집 및 이용 목적 : 채용전형의 진행, 채용 진행사항 관련 안내, 인재풀 등록 및 활용  ○ 보유 및 이용 기간 : **이용목적 달성시 까지** |

귀하께서는 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부하실 권리가 있습니다. 하지만 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 거부하실 경우 당사 채용전형이 진행되지 않을 수 있습니다.

  위 개인정보 수집∙이용에 동의 합니다. 동의함 □, 동의하지 않음 □

**2. 개인정보의 제 3자 제공 동의**

회사는 수집된 개인정보를 이용자의 동의가 있는 경우에 한하여 아래와 같이 제3자에 제공하고 있습니다. 귀하께서는 귀하의 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부하실 권리가 있습니다. 하지만 개인정보 제3자 제공 동의를 거부하실 경우 당사 채용전형이 진행되지 않을 수 있습니다.

1) 자격사항 검증

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제공받는 곳 | 제공항목 | 제공목적 | 보유기간 |
| **멀티캠퍼스, 한국토익위원회, 한국어문회, 한자교육진흥회, 한국외국어평가원, 대한검정회, YBM시사, 대한상공회의소, 한국BCT사업본부, HSK한국사무국** | 성명, 생년월일, 자격종류, 자격번호, 등급, 점수, 취득일자, 응시일자 | **자격사항 검증** | **이용목적**  **달성시 까지** |

위 개인정보 제3자 제공에 동의 합니다. 동의함 □, 동의하지 않음 □

2) 채용 건강검진

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제공받는곳 | 제공항목 | 제공목적 | 보유기간 |
| **강북삼성병원, 창원삼성병원** | 성명, 생년월일, 회사명, 핸드폰번호 | **채용건강검진** | **이용목적**  **달성시 까지** |

위 개인정보 제3자 제공에 동의 합니다. 동의함 □, 동의하지 않음 □

**2025년      월      일      성명 :                 (인 또는 서명)**

**삼성디스플레이주식회사 귀중**